

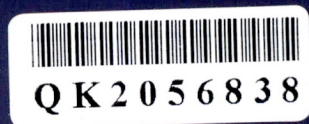
ISSN 1681-1070
CN 32-1709/TN

电子与封装

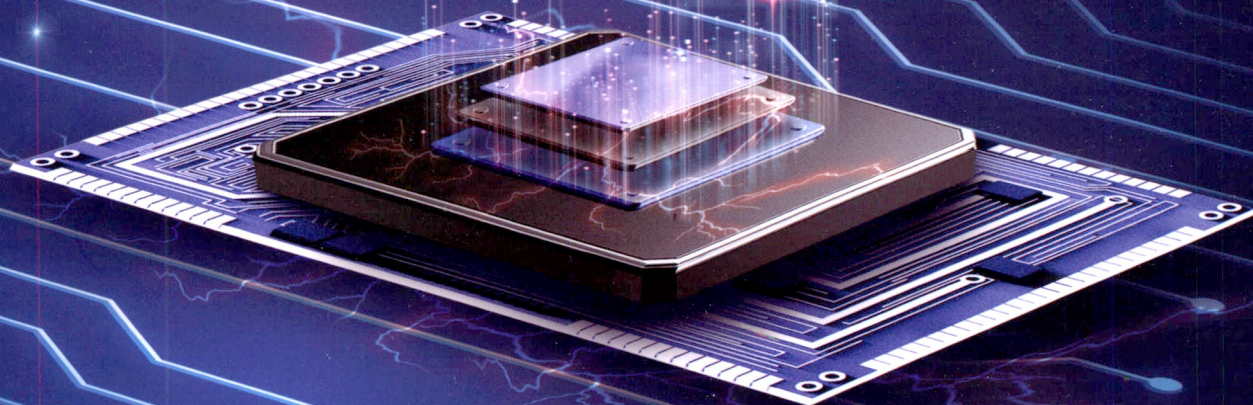
ELECTRONICS & PACKAGING

中国电子学会电子制造与封装技术分会会刊

中国半导体行业协会封装分会会刊



QK2056838



后摩尔时代的技术创新

P120101

可编程多级级联积分梳状
内插滤波器的设计

P120305

MIS型GaN HEMT器件的
X-ray辐射总剂量效应研究

P120403

ISSN 1681-1070

www.ep.org.cn

主管：中国电子科技集团公司

主办：中国电子科技集团公司第五十八研究所

2020年 12月
第20卷（卷终）第12期



扫码关注杂志
微信公众号



9 771681 107203

万方数据

中国电子学会电子制造与封装技术分会会刊
中国半导体行业协会封装分会会刊

电子与封装

Dianzi Yu Fengzhuang

2001年创刊(月刊)

2020年12月第20卷(卷终)第12期
(总第212期)

编辑委员会

顾问: 王阳元 叶甜春 许居衍
俞忠钰 郑敏政 郝跃
宫承和

名誉主任: 毕克允

主任: 李斌

副主任: (按姓氏笔画排序)
王红 王新潮 石明达
肖胜利

委员: (按姓氏笔画排序)
丁荣峥 于宗光 田艳红
王栋 王静 刘胜
庄奕琪 李丽 肖志强
时龙兴 陆坚 沈阳
张卫 张波 张崎
金玉丰 罗宏伟 卓鸿俊
明雪飞 封晴 高岭
徐冬梅 顾晓峰 黄凯
程凯 曹立强 蔡坚

主管: 中国电子科技集团公司
主办: 中国电子科技集团公司
第五十八研究所

编辑出版: 《电子与封装》编辑部

主编: 余炳晨

万方数据

目次

综述

120101 后摩尔时代的技术创新……………许居衍, 黄安君

封装、组装与测试

120201 DDR3堆叠键合组件的信号完整性分析与优化
……………曾燕萍, 张景辉, 王梦雅, 孙晓冬, 曹春雨

120202 PTC封装结构热管理模拟研究
……………张墅野, 杜轩宇, 林铁松, 何鹏

120203 基于弹性连接器的板级垂直互连技术
……………王辉, 徐榕青, 董乐, 李阳阳, 庞婷

120204 2.5D器件中硅通孔结构设计
……………赵文中, 樊帆, 林鹏荣, 谢晓辰, 杨俊

电路设计

120301 一种宽范围输入电压的驱动电路设计……………张艳飞, 曹正州

120302 柔性透明屏LED驱动芯片设计……………夏云汉, 李鸣晓, 范学仕

120303 基于VPR的FPGA架构建模研究
……………蔡宏瑞, 范继聪, 徐彦峰, 闫华, 胡凯

120304 嵌入式温度模块设计……………秦拴宝, 殷华文

120305 可编程多级级联积分梳状内插滤波器的设计
……………范晓捷, 王祖锦, 张甘英, 朱夏冰, 万书芹

微电子制造与可靠性

120401 智能家电电路典型失效机理与设计缺陷
……………肖诗满, 陈军, 纪瑶, 夏江, 杨林

120402 重掺衬底对硅外延过程中系统自掺杂的影响
……………杨帆, 马梦杰, 金龙, 王银海

120403 MIS型GaN HEMT器件的X-ray辐射总剂量效应研究……………吴素贞,
徐政, 徐海铭, 宋思德, 谢儒彬, 洪根深, 吴建伟, 贺琪

120404 硅外延电阻率测试稳定性研究
……………杨帆, 黄宇程, 王银海, 潘文宾

Electronics & Packaging

(Monthly)

Vol. 20, No. 12

Dec. 2020

(End of the Volume 20)

CONTENTS

Reviews

- 120101 Technological Innovation in the Post-Moore Law Period
.....XU Juyan, HUANG Anjun

Packaging & Assembly & Testing

- 120201 Signal Integrity Analysis and Optimization of DDR3 Stacked Bonding Module.....ZENG Yanping, ZHANG Jinghui, WANG Mengya, SUN Xiaodong, CAO Chunyu
- 120202 Thermal Management Simulation of PTC Package Structure
.....ZHANG Shuye, DU Xuanyu, LIN Tiesong, HE Peng
- 120203 Board-level Vertical Interconnection Based on Elastic Connector
.....WANG Hui, XU Rongqing, DONG Le, LI Yangyang, PANG Ting
- 120204 The Structure Design of Through Silicon Via in 2.5D Devices
.....ZHAO Wenzhong, FAN Fan, LIN Pengrong, XIE Xiaochen, YANG Jun

IC Design

- 120301 A Design of Driver Circuit with Wide Input Voltage
.....ZHANG Yanfei, CAO Zhengzhou
- 120302 Design of LED Driver Chip for Flexible Transparent Screen
.....XIA Yunhan, LI Mingxiao, FAN Xueshi
- 120303 Research of FPGA Architecture Modelling Based on VPR
.....CAI Hongrui, FAN Jicong, XU Yanfeng, YAN Hua, HU Kai
- 120304 Design of Embedded Temperature Module
.....QIN Shuanbao, YIN Huawen
- 120305 Design of a Programmable Multi-Stage Cascade Integrating Comb Interpolation Filter.....FAN Xiaojie, WANG Zujin, ZHANG Ganying, ZHU Xiabing, WAN Shuqin

Microelectronics Fabrication & Reliability

- 120401 Typical Failure Mechanisms and Design Defects of Intelligent Household Appliances
.....XIAO Shiman, CHEN Jun, JI Yao, XIA Jiang, YANG Lin
- 120402 The Effect of Heavily Doped Substrate on System Autodoping of Silicon Epitaxy
.....YANG Fan, MA Mengjie, JIN Long, WANG Yin Hai
- 120403 Study of X-ray Total-Ionizing-Dose Effect in MIS Type GaN HEMT Device.....WU Suzhen, XU Zheng, XU Haiming, SONG Side, XIE Rubin, HONG Genshen, WU Jianwei, HE Qi
- 120404 Research on the Stability of Silicon Epitaxial Resistivity Test
.....YANG Fan, HUANG Yucheng, WANG Yin Hai, PAN Wenbin

万方数据

《电子与封装》编辑部

地 址: 无锡市建筑西路777号

邮 编: 214072

电 话: 0510-85860386

传 真: 0510-85802157

电子邮箱: ep.cetc58@163.com (稿件咨询)

ep1_cetc58@163.com (公众号合作)

ep2_cetc58@163.com (编务、发行)

投稿官网: www.ep.org.cn

公 众 号: 电子与封装(ep_cetc58)

刊 号: ISSN 1681-1070

CN 32-1709/TN

印 刷: 无锡市人民印刷厂有限公司

发 行: 《电子与封装》编辑部

发行范围: 国内外公开发行

出版日期: 每月20日

定 价: 10元

《电子与封装》编辑部声明

为适应我国信息化建设,扩大本刊及作者知识信息交流渠道,本刊已被以下数据库等收录,其作者文章著作权使用费与本刊稿酬一次性给付。如作者不同意文章被收录,请在来稿时向本刊声明,本刊将作适当处理。

CNKI中国期刊全文数据库收录期刊

中国学术期刊综合评价数据库统计源期刊

《中国核心期刊(遴选)数据库》收录期刊

“万方数据~数字化期刊群”上网期刊

《中文科技期刊数据库(全文版)》收录期刊

国家科技学术期刊开放平台

超星期刊域出版平台

电子与封装

Dianzi Yu Fengzhuang

2001年创刊 (月刊)

2020年 12月 第20卷 (卷终) 第12期
(总第212期)

Electronics & Packaging

Started in 2001 (Monthly)

Vol. 20, No. 12

Dec. 2020 (End of the Volume 20)
(Series No. 212)

主 管：中国电子科技集团公司
主 办：中国电子科技集团公司
第五十八研究所
编辑出版：《电子与封装》编辑部
编委主任：李 斌
主 编：余炳晨
地 址：无锡市建筑西路777号
邮 编：214072
电 话：0510-85860386
传 真：0510-85802157
电子邮箱：ep.cetc58@163.com
网 址：www.ep.org.cn
公 众 号：ep_cetc58
印 刷：无锡市人民印刷厂有限公司
发 行：《电子与封装》编辑部

Sponsored by: CETC58
Edited & Published by: Editorial Department of
Electronics & Packaging
Director of Editorial Board: LI Bin
Chief Editor: YU Bingchen
Add: No. 777 West Jianzhu Road,
Wuxi 214072, China
Tel: 86-510-85860386
Fax: 86-510-85802157
E-mail: ep.cetc58@163.com
Website: www.ep.org.cn
WeChat Official Account: ep_cetc58
Printed by: Wuxi People Printing Factory
Distributed by: Editorial Department of
Electronics & Packaging

刊号：ISSN 1681-1070
CN32-1709/TN

发行范围：国内外公开发行
定 价：10.00 元